

e Edge Computing

～次世代データで導きだす持続可能な社会の実現に向けて～

2023年5月31日(水)～6月2日(金)
東京ビッグサイト東展示棟

【共催】株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会

※電子機器トータルソリューション展2023と同時開催

申込受付開始!

2009年には10億台程度と言われていたIoTデバイスは、2025年には400億台以上を超えるとの見通しが発表され、インターネットに接続されたデバイスが、膨大なデータを生成する時代が到来しています。

そして、このデータを安定的に処理・分析・運用するため、「エッジコンピューティング」に注目が集まっています。

また、マーケットでは5Gの整備が進み、自動運転、スマート工場、遠隔医療、スマートシティなどの技術イノベーションが活況を呈し、

リアルタイムな分散処理が可能となるエッジコンピューティングへの期待が高まっています。

このような背景から低遅延・高信頼・通信量低減を実現する「Edge Computing」は、Smart Sensing/無人化ソリューション展と同時開催をすることによって、センシングを基盤とした「データ収集」「データ分析」「データ活用」を一覧できる展示会として来場者にとっても理解しやすくなることを目的にしています。ぜひご期待ください。

開催概要

名称: Edge Computing 2023
会期: 2023年5月31日(水)～6月2日(金)
会場: 東京ビッグサイト東展示棟
共催: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会
小間仕様: 1小間/9m²(3mx3m・スペースのみ)

出展料: 【通常価格】451,000円(税込)
【早期割引】360,800円(税込)
同時開催: 電子機器トータルソリューション展2023
(2022年開催実績:出展者数313社、出展小間数845小間、
来場者数27,972名)
早期申込締切: 2023年1月31日(火)
最終申込締切: 2023年2月28日(火)

電子機器トータルソリューション展2023とは

5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル、最先端光学システム等を具現化する技術を紹介する12展が集う総合展示会です。

JPCA Show

マイクロエレクトロニクスショー

JISSO PROTEC

SDGsデバイス展

WIRE Japan Show

Smart Sensing

Electronics Component & Unit Show

E-Textile/Wearable

interOpto

Imaging Japan

Edge Computing

無人化ソリューション展

出展対象: エッジソリューション

低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューションを提供する企業・団体

●ハードウェアソリューション

CPU/MCU、FPGA、DSP、エッジデバイス、センサーソリューション、ネットワークソリューション、ボードコンピュータ/シングルボードコンピュータ

●ソフトウェアソリューション

OS、ミドルウェア、画像分析、音声分析、エッジAI、アプリケーション

●システムソリューション

各種システム、エッジセキュリティ

●プラットフォーム、開発ツール、インテグレーションサービス

来場対象

エレクトロニクス分野でも専門性の高い企業、研究団体の方が来場します。

自動車関連、OA/ロボティクス、情報・通信関連、AV・家電関連、医療機器関連、半導体デバイス関連、航空・宇宙関連、光技術、電子回路基板、その他

出展申込締切日: 2023年2月28日(金)

<https://edgecomputing.jp>



電子機器トータルソリューション展2023 構成展のご紹介

電子回路技術



第52回国際電子回路産業展

- プリント配線板技術展**
製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム
 - 半導体パッケージング・部品内蔵技術展**
モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般(製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
 - フレキシブルプリント配線板製品出展エリア**
フレキシブルプリント配線板に関する技術全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
 - 機器・半導体受託生産システム展**
EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
- 主催：一般社団法人日本電子回路工業会

高密度実装技術



第37回 最先端実装技術・パッケージング展

実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージング/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)

主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

電子部品実装技術



第24回 実装プロセステクノロジー展

- 電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品搭載機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオープン)、ディスプレイ
 - 実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ・その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤
 - 半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム
 - 産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR
 - 検査・試験装置：基板外観検査装置 半導体製造関連検査・測定装置
 - 実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置
 - 実装デバイス、部品および関連材料 ■実装デバイス包装材料
 - 実装接合システム、はんだ/接合材料
 - 高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料
- 主催：一般社団法人日本ロボット工業会

SDGs 具現化技術



SDGs デバイス展

- ・再生可能エネルギー関連エレクトロニクス
 - ・パワーエレクトロニクス関連 実装/材料
 - ・パワー半導体/パワーデバイス(IGBT、MOSFET、バイポーラトランジスタ等)、各種メモリ(S-RAM、D-RAM、等)、半導体パッケージ、部品内蔵モジュール、メタルコアプリント配線板、熱ソリューション、太陽電池、バッテリー、水素燃料、パワエレ、関連各種デバイス、他
- 主催：一般社団法人日本電子回路工業会
電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)

電気・光伝送技術



電気・光伝送技術展

ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部品/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
電線新聞((株)工業通信)

半導体・電子部品



全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

高機能テキスタイル



イーテキストイル/ウェアラブル展

電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキストイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社織研新聞社

センサー技術



スマートセンシング

センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

無人化技術・ソリューション



無人化ソリューション展

無人化技術・ソリューション、または無人化のための省力化・遠隔化・自動化・非接触化の技術・ソリューション全般
監視システム/遠隔操作システム/先進運転支援システム/ティープラニング/非接触・タッチレス/無人営業サービス/AR/異常検知/顔認証/AI等

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

エッジソリューション技術



エッジコンピューティング

低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般
ボードコンピュータ・シングルボードコンピュータ/エッジデバイス/OS/エッジAI/アプリケーション/画像分析/エッジセキュリティ/各種システム等

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

光&次世代アプリケーション・ネットワークシステム

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION



インターオプト

レーザー・光源(半導体、ファイバ、超短パルス)/光素子・部品(レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ)/測定装置・光分析機器/生産向けレーザーシステム(レーザー加工装置、マーキング装置)/光情報通信(可視光通信、5G)

主催：一般財団法人光産業技術振興協会
企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

画像処理・センシング技術



イメージングジャパン

各種カメラ・センサー機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LiDAR

主催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

申込方法

右記の公式ホームページからお申込みください。

<https://edgecomputing.jp>



今後のスケジュール

1月31日(火)
早期割引締切

2月28日(火)
最終申込締切

4月上旬
来場登録開始

5月29日(月)・30日(火)
搬入日



3月上旬(予定)
出展マニュアル
データ配布・
出展者説明会(オンライン)

3月下旬(予定)
小間位置発表

5月31日(水)~6月2日(金)
会期(※最終日即日撤去)

出展についてのお問合せ先